

证券代码：688093

证券简称：世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	特定对象调研、现场参观
参与单位名称	安信基金、东北证券、浙江火炬中心（以上排名不分先后）
时间	2026年3月31日
地点	公司会议室
总接待次数	1场
公司接待人员姓名	董事、战略总监：张乃奎 董事会秘书：计毓雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司基本情况介绍。 答：公司成立于 2010 年，一直以来专注于功能性材料的自主研发创新，在合成改性、提纯分散、材料设计、薄膜形成、分析科学等方面具备数十项核心技术能力。公司建立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，立足于复合功能性材料，持续拓展 AI 终端设备、显示面板、集成电路、智能汽车等行业应用，致力于成为具备国际竞争力的平台化材料企业。</p> <p>2. 公司产品介绍。 答：公司主营产品包括功能性电子材料、高性能光学材料和功能性粘接剂。公司功能性电子材料主要是应用在电子产品内部或其制造组装过程中的复合功能性材料，实现粘接、导热、导电、屏蔽、缓冲等功能或在产品智能化生产过程中实现抗静电、耐高温、抗腐蚀、防刮伤等器件保护功能。高性能光学材料主要为应用于 OLED/LCD 等显示面板或其生产过程中的光学级复合功能性材料，对材料透射、反射、抗眩光、耐黄变、洁净度等光学特性及抗静电、防尘、防污、屏蔽、导热、抗翘曲、耐候性等性能有较高要求。功能性粘接剂是一类具有包括优异的粘接性能、填充性能、密封性能或光学特性的功能性高分子材料，同时可具备耐高温、耐腐蚀、导电、阻燃等性能，形态为液态。公司业务结构仍在不断优化中，每类业务的逻辑有所不同，随着业务结构的优化，公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动。</p> <p>3. 介绍下公司 2025 年定增项目建设进展？ 答：公司 2025 年度定增项目建设进展顺利，厂区已于 2026 年 1 月完成主体结构封顶，预计 2026 年开始生产设备将陆续进场安装。后续公司将继续加快推进项目建设，争取早日实现投产。</p>

4. 公司密封胶项目生产情况如何？

答：公司高效密封胶项目位于张家港，2024 年试生产，2025 年正式投产，产品用于自用和外售。该项目产能处于持续爬坡阶段。公司将于 4 月 18 日披露 2025 年年度报告，具体经营情况可关注年报。

5. 公司今年是否有股权激励计划？

答：公司若有相关计划，将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

6. 公司对未来展望如何？

答：从长期战略布局来看，公司未来将逐渐形成以高性能光学材料、功能性电子材料和功能性粘接剂三大品类为主的产品结构。其中，功能性电子材料是公司目前的主营业务，公司在该类业务上在持续拓展新客户和新的应用场景；高性能光学材料是公司的第二增长曲线，验证难度大、验证周期长、技术门槛高，但是体量相对较大，后续将依托新建的高性能光学胶膜材项目进一步扩充产能；功能性粘接剂是公司的种子业务，已开始产生少量营收贡献，未来将是公司新的增长点。